

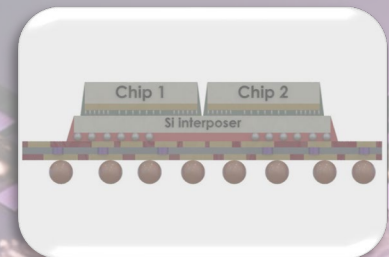
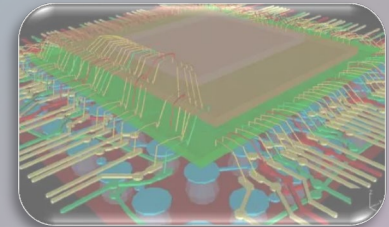
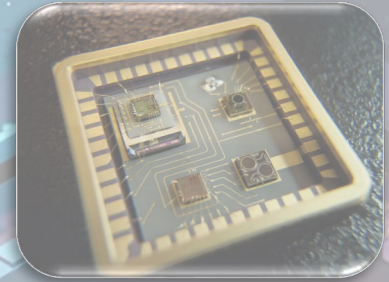
# Tecnologías de System in Package

Microcredencial 3 ECTS (20h aula + 10h lab.)


**CÁTEDRA UPM – INDRA en MICROELECTRÓNICA**


## ¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Tecnologías de encapsulado emergentes SiP y SoC
2. Ventajas de las tecnologías SiP
3. Retos y limitaciones de las tecnologías SiP
4. Componentes de un SiP: circuitos integrados, componentes pasivos, tecnologías de interconexión
5. Diseño y fabricación de SiPs (técnicas de diseño, ensamblado y encapsulado)
6. Prueba y verificación de SiPs



**PRECIO DE LA  
MATRÍCULA 100%  
GRATUITO. FINANCIADO  
POR CÁTEDRA  
UPM-INDRA**

 28/05/2025 al 16/07/2025 (X y J) de 17:00h a 19:00h

 SEMIPRESENCIAL. Laboratorios y aulas de la ETSI Telecomunicación

 [comunidad.microelectronica@upm.es](mailto:comunidad.microelectronica@upm.es)

**PREINSCRÍBETE**